**Anfrageformular - Neuprodukt**

**LP-Bezeichnung/Projektname:** Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Version/Revision:** Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**LP-Maße:** Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Menge (ggf. einzelne Abrufe, Jahresbedarf?):** Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Wunsch-Liefertermin:** Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Leiterplattendefinition:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Basismaterial:** | FR4 (Standard) | Sondermaterial 🡪 Bezeichnung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **LP-Dicke:** | 0,8mm  2,0mm | 1,0mm  2,4mm | 1,55mm  3,2mm |
| Andere: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| ***Cu* Enddicke:** | 35µm | 70µm | 105µm |
| **LP-Art:** | doppelseitig | Multilayer 🡪 Lagenanzahl: **XX** | |
| **Lagenaufbau:** | symmetrisch (Standard) | definierter Lagenaufbau als Anlage | |
| **Leiterstrukturen:** | >=200µm  >=120µm | >=180µm  >=100µm | >=150µm  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Oberfläche:** | HAL (Standard) | chem. Silber | chem. Nickel-Gold |
| chem. Zinn | Andere: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Lötstopp (inkl. Angaben zu Seite/Farbe):** | Lack beidseitig fotosensitiv grün (Standard) | Anderer: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Kennzeichnung (inkl. Angaben zur Farbe):** | Herstellerkennung  UL-Kennzeichen  im Lötstopplack auf *Cu*  KEINE extra Kennzeichnung | DateCode  im *Cu* ohne Lötstopplack  im Lötstopplack auf Basismaterial  Sonstige/Farbe: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Anzahl Bohrungen insgesamt:** | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  🡪 davon inkl. Durchkontaktierungen:  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |

**Hinweis:** Die Positionen der Kennzeichen sind im Bestückungsplan anzugeben!

**Bestückung & Sonstiges:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fertigung:** | RoHS-konform (Standard) | **VERBLEIT** |
| **SMT-Bestückung:** | 1-seitig | 2-seitig |
| **THT-Bestückung:** | 1-seitig | 2-seitig |
| **AOI-Test:** | Ja Nein | nur Sichtkontrolle |
| **Programmierung (z.B. von PICs etc.):** | Ja | Nein |
| **E-Test:** | Ja | Nein |
| **Erstmusterfreigabe gewünscht:** | Ja | Nein |
| **Etikettierung (z.B. mit Seriennummer):** | Ja | Nein |
| **Material-Beistellung (kompl. inkl. LP) durch Kunden:** | Ja Nein | nur Teilbeistellung  LP wird nicht beigestellt |
| **Nutzentrennung:** | Ja | Nein |
| **Baugruppen reinigen:** | Ja | Nein |
| **Verpackung:** | ESD-Leihkarton  ESD-Einzelverpackung | Andere: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| **Herstellerbindung (z.B. für Bauelemente 🡪 in Stückliste vermerken!):** | Ja | Nein |
| **Herstellerquote (Preis) vorhanden:** | Ja 🡪 Distributor: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Nein |
| **Staffelpreise:** | Staffeln: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| **Angebotstyp:** | **preisoptimiert** | **lieferzeitoptimiert** |

**Hinweis:** Baugruppen werden standardmäßig AOI-geprüft (BGAs per X-Ray; bei Prototypen & Kleinserien auf Anfrage). Inkl. Material-Traceability auf Auftragsebene bis zur Herstellercharge sowie Prozess- und Prüfdaten-Traceability. **SMD-Material durch Kundenbeistellung muss maschinenverarbeitbar sein (ausschließlich Rollen-, Stangen- oder Tray-Ware), ansonsten behalten wir uns eine Preisanpassung für die Handbestückung vor.**

*> Bitte unbedingt den* ***kompletten Gerberdatensatz*** *(inkl. Bestückkoordinaten, Positionsdruck, Lötstopp, Kupfer/Leiterbahnen und Öffnungen/Pads für die SMD-Schablone) sowie* ***Summenstückliste*** *[inkl. Angaben zu Bauteilbezeichnung, Bauform, Dielektrikum, Temperaturkennwerten und Toleranzen; als Excel-Datei] und* ***ggf. spezielle Arbeitsanweisungen für die (THT-)Montage*** *im Anhang mitsenden. Gern auch Bilder einer Muster-BG.<*

**Zusatzinformationen (Angaben zu Alternativbauteilen/Beistellteilen, Prüfanweisungen für E-Tests, Einpresstechnik, Freigabeschreiben für LOA-Artikel, erlaubte Trennverfahren bei Nutzentrennung, Etikettierung/ Beschriftung, Fertigungsanweisungen, gesperrten Herstellern, Glanzgrad der Lötstoppmaske, LP-Zertifizierung [CSA, UL etc.], Nutzenaufbau, Trocknungsprozessen, QS, Verbleib des Restmaterials, Viadruck, Vertraulichkeitserklärung [ggf. im Anhang mitsenden], Vorgaben zur Lotlegierung bzw. zum Lothersteller, zusätzliche Klebepunkte etc.):**

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

**Akzeptierte Datenformate:**

Eagle BRD-Datei, Microsoft Excel, ODB++, RS-274-D (Standard Gerber), RS-274-X (Extended Gerber)

**Abnahmekriterien:**

Als Abnahmekriterium für elektr. Baugruppen gilt die aktuelle Fassung der "IPC-A-610" (Klasse?).